



中华人民共和国国家标准

GB/T 35010.4—2018/IEC/TR 62258-4:2012

半导体芯片产品 第4部分：芯片使用者和供应商要求

Semiconductor die products—
Part 4: Requirements for die users and suppliers

(IEC/TR 62258-4:2012, Semiconductor die products—
Part 4: Questionnaire for die users and suppliers, IDT)

2018-03-15 发布

2018-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总则	1
5 数据交换	2
附录 A (规范性附录) 芯片器件使用者信息表	3
参考文献	14

前 言

GB/T 35010《半导体芯片产品》分为以下几部分：

- 第 1 部分：采购和使用要求；
- 第 2 部分：数据交换格式；
- 第 3 部分：操作、包装和贮存指南；
- 第 4 部分：芯片使用者和供应商要求；
- 第 5 部分：电学仿真要求；
- 第 6 部分：热仿真要求；
- 第 7 部分：数据交换的 XML 格式；
- 第 8 部分：数据交换的 EXPRESS 格式。

本部分为 GB/T 35010 的第 4 部分。

本部分使用翻译法等同采用 IEC/TR 62258-4:2012《半导体芯片产品 第 4 部分：芯片使用者和供应商信息表》。

与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

- GB/T 2900（所有部分） 电工术语[IEC 60050(所有部分)]。

本部分做了下列编辑性修改：

- 考虑与我国标准体系相适应，将名称改为“半导体芯片产品 第 4 部分：芯片使用者和供应商要求”。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由全国半导体器件标准化技术委员会(SAC/TC 78)归口。

本部分起草单位：华天科技(昆山)电子有限公司、天水七四九电子有限公司、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司。

本部分主要起草人：于大全、万里兮、孙瑜、王紫丽、翟玲玲、宋赏、苗文生、孙宏伟。

半导体芯片产品

第 4 部分：芯片使用者和供应商要求

1 范围

GB/T 35010 的本部分用于指导半导体芯片产品的生产、供应和使用，半导体芯片产品包括：

- 晶圆；
- 单个裸芯片；
- 带有互连结构的芯片与晶圆；
- 小尺寸或部分封装的芯片与晶圆。

本部分包含 GB/T 35010 其他部分需求的信息表，本部分适用于芯片产品的供应商与使用者之间的协商与签约。目的是帮助所有芯片产品供应链的制造商参照 GB/T 35010.1—2018 和 GB/T 35010.2—2018 标准的相关要求执行。

需要注意的是，本部分中的表格构成了可能被提供的一个信息清单，就实际产品和所有领域所涉及的信息有所欠缺。这里，针对不同的市场可能需要将这些信息纳入。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 35010.1—2018 半导体芯片产品 第 1 部分：采购和使用要求(IEC 62258-1:2009, IDT)

GB/T 35010.2—2018 半导体芯片产品 第 2 部分：数据交换格式(IEC 62258-2:2011, IDT)

IEC 60050(所有部分) 国际电工词汇(International Electrotechnical Vocabulary)

3 术语和定义

IEC 60050(所有部分)、GB/T 35010.2—2018 界定的术语和定义适用于本文件。

4 总则

为了与 GB/T 35010.1—2018 保持一致，需要芯片器件供应商为器件使用者提供产品在设计、采购、制造和测试全过程的必要和充分的信息。附录 A 中的信息表提供了信息交流的基本内容及格式，以达到符合标准。

本部分引用的参考条款在标准 GB/T 35010.1—2018 和 GB/T 35010.2—2018 中，它们仅适用于该版本标准。附录 A 中包含未被上述标准涵盖但将被列入后续版本中的所需信息。而且，一些术语可能不完全符合 GB/T 35010 的其他部分。例如，术语“焊盘”(或称“键合区”)在本部分中被替换为“引出端”。

同时，所提供的大部分信息应符合相关标准，并公开于公共领域，且信息源能以制造商数据表格的形式追溯，但并不要求制造商承担信息公开化的义务。任何涉及专利或商业敏感的信息，制造商可以采取非披露形式予以保护。